

证券代码：688049

证券简称：炬芯科技

炬芯科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	富国基金 兴业证券 鑫元基金 华创证券 兴银基金 中金资管 华源证券 兴银理财 中银资管
会议时间	2025年11月28日-12月25日
会议地点	公司会议室、线上会议
上市公司接待人员姓名	证券事务代表：程奔驰
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1：存内计算技术面向客户是哪些，客户导入进展如何？</p> <p>答：公司已正式发布的搭载第一代存内计算技术产品共包括三个芯片系列：第一个系列是 ATS323X，面向低延迟高音质私有无线音频领域；第二个系列是 ATS286X，面向蓝牙 AI 音频领域；第三个系列是 ATS362X，面向端侧 AI 处理器领域。接下来，公司将会发布第四个系列，即面向智能穿戴领域的 ATW609X 芯片。</p> <p>目前 ATS323X 已搭载于品牌客户无线麦克风产品量产上市，取得了优异的市场表现，其他品牌客户产品也接近上市发布；ATS362X 已立项导入头部品牌客户多款产品中，部分客户产品有望在近期发布上市。</p> <p>Q2：今年第一代存内计算产品在营收中占比如何，对销售单价的拉动</p>

	<p>影响大么？</p> <p>答：公司新产品目前已随客户产品上市并开始贡献营收，随着下游多条线品牌客户的陆续导入立项，预计逐步将会对销售单价持续产生正向拉动。</p> <p>Q3：第二代存内计算技术的芯片什么进展？</p> <p>答：公司第二代存内计算技术 IP 研发稳步推进中，目标实现下一代芯片单核 NPU 算力倍数提升、能效比大幅优化，并全面支持 Transformer 模型。</p> <p>Q4：公司今年前三季度业绩表现超出市场预期，对 2026 年如何展望？</p> <p>答：目前公司所深耕的下游应用市场大部分仍然保持着较为良好的景气度，根据客户导入项目来看，我们对 2026 年度继续保持相对乐观的展望。</p> <p>Q5：AI 眼镜方面公司已经落地的和在研推进的项目有哪些？</p> <p>答：基于公司 ATS308X 的 AI 眼镜解决方案，已有 INMO、Halliday、形意智能三家客户正式发布了三款 AI 眼镜产品。公司即将发布新一代面向智能穿戴领域的 ATW609X 系列芯片，采用三核架构，搭载公司第一代存内计算技术。目前基于 ATW609X、ATS308X 方案已有多家客户的多种形态 AI 眼镜产品正在研发推进中，将陆续发布上市。</p> <p>Q6：近期看到 AI 在端侧硬件方面的创新？</p> <p>答：在端侧 AI 硬件创新和存量产品 AI 化升级方面下游客户保持着较高的热情，硬件创新方面下游客户推出的 AI Note 产品和 AI 眼镜产品代表了两个方向，其中 AI Note 产品作为生产力辅助工具提升了行政人员、销售人员的工作效率，AI 眼镜产品正在不断迭代并提升消费者的佩戴体验；存量升级方面，绝大部分与音频、语音有关的产品都在被 AI 重新赋能，芯片原厂和下游客户正在推动硬件架构升级和端侧专用模型的落地工作，目前已有公司客户部署端侧专用 AI 降噪模型的领夹麦克风产品上市并热销，其他类别如音箱、穿戴类产品也将陆续推进产品 AI 化升级。</p> <p>Q7：今年以来销售增速较快的产品线有哪些？</p>
--	---

	<p>答：公司增速较快的是低延迟高音质无线音频 SoC 芯片、蓝牙音箱 SoC 芯片和端侧 AI 处理器芯片产品。其中：在低延迟高音质无线音频芯片市场，公司把握无线麦克风市场、无线电竞耳机、无线家庭影院音响系统有线转无线化的趋势，取得了同比显著增长；在蓝牙音箱市场，公司国际一线品牌持续提升渗透率，获得了稳健的增长；在端侧 AI 处理器市场，公司突出在低功耗下提供大算力的特点，为客户提供优秀的解决方案，产品出货量实现倍数提升。</p> <p>Q8：关于收并购公司的想法，是否会有一定倾向性，近期公司筹划启动 H 股上市是否会与此有关联？</p> <p>答：收并购是国内外上市公司实现增长的一个重要途径，公司会从标的资产的协同效应、市场规模以及增长前景等多个角度对潜在的标的资产进行评估筛选，后续如涉及相关重大事项，公司将按照规定及时履行信息披露义务。公司于近日发布了筹划发行 H 股股票并在联交所上市的公告，目的在于充分借助香港国际资本市场的优势，进一步满足公司全球化发展战略及海外业务布局的需要。</p> <p>Q9：端侧 AI 处理器营收增速很快，目前的应用场景是什么，可以实现什么效果？</p> <p>答：公司端侧 AI 处理器芯片可为声纹识别、智能 AI 降噪、声场定位、多音轨分离（包括人声分离，乐器分离等）、人声增强、语义分析、AI 美声、AI 变声、AI 音效等为代表的众多实际应用场景提供充足的 AI 算力，可广泛应用在以 Party 音箱以及声卡、调音台、专业麦克风、会议系统等为代表的专业音频设备中。</p>
是否涉及应当披露重大信息的说明	不涉及
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 12 月 27 日